

(12)特許協力会員に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際専務局(43)国際公開日
2005年1月27日 (27.01.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/008788 A1

(51)国際特許分類: H01L 31/10, 27/14

(21)国際出願番号: PCT/JP2004/010410

(22)国際出願日: 2004年7月22日 (22.07.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:

特許2003-278567 2003年7月23日 (23.07.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1126 番地の 1 Shizuoka (JP).

(72)発明者; および

(73)発明者/出願人(米国についてのみ): 舟山 勝己 (SHIBAYAMA, Katsumi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1126 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

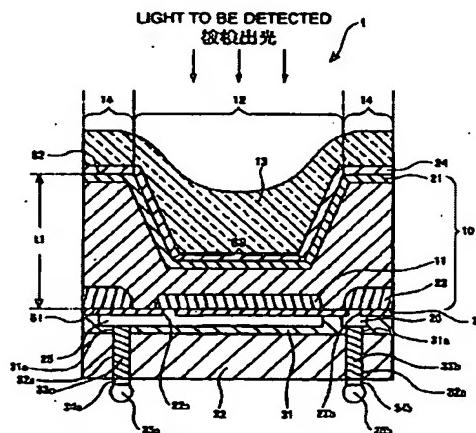
(74)代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 10 番 6 号 銀座ファーストビル 創英國際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, ER, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

(複数有)

(54) Title: BACKSIDE-ILLUMINATED PHOTODETECTOR

(54)発明の名称: 裏面入射型光検出素子



(57) Abstract: A backside-illuminated photodetector is disclosed which enables to sufficiently reduce the package size and is capable to suppress scattering of light to be detected. A backside-illuminated photodiode (1) comprises an N-type semiconductor substrate (10), a P⁺-type impurity semiconductor region (11), a recessed portion (12), and a coating layer (13). The P⁺-type impurity semiconductor region (11) is formed in a surface layer on the front side (S1) of the N-type semiconductor substrate (10). The recessed portion (12), on which a light to be detected is incident, is formed in a region on the backside (S2) of the N-type semiconductor substrate (10) which region is opposite to the P⁺-type impurity semiconductor region (11). The backside (S2) is also provided with the coating layer (13) which transmits the light to be detected to the recessed portion (12). A portion of the coating layer (13) formed on the recessed portion (12) is dented when compared with the other portion formed on a peripheral portion (14) surrounding the recessed portion (12).

A1
WO 2005/008788

(57) 優れた: パッケージを充分に小さくでき、且つ被検出光の散乱を抑制することができる裏面入射型光検出素子を提供することを目的とする。裏面入射型ホトダイオード 1 は、N型半導体基板 10、P⁺型不純物半導体領域 11、凹部 12、及び被覆層 13 を備えている。N型半導体基板 10 の表面 S1 側における表面には、P⁺型不純物半導体領域 11 が形成されている。N

(複数有)